

## 技術詞彙表

本技術詞彙表載有本文件所用與本公司及其業務有關的若干詞彙的釋義。該等詞彙及涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法相符。

「3C」	指	計算機、通信和消費電子產品
「AI」	指	人工智能
「bay」	指	半導體晶圓廠中的模塊化區域，旨在支持高效、可擴展及乾淨的半導體加工操作
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「CBB」	指	通用基礎模塊，一種標準模塊系統，將機器人解構為可配置的構建模塊，支持高效組成多形態移動操作機器人
「CE」	指	Conformite Europeenne，一個驗證若干產品在歐洲經濟區銷售和使用是否安全的監管標準
「控制器」	指	連接至機器人以控制機器人運動的系統
「控制論法」	指	一種透過持續監察行動並利用反饋進行調整來控制和改進系統的方法
「具身智能」	指	能夠運用包括傳感器、電機、機器學習和自然語言處理在內的一系列技術，與環境交互並從中學習的人工智能系統
「進化算法」	指	一種人工智能類型。進化算法的靈感來自我們在自然界中觀察到的優化過程，例如自然選擇、物種遷移、鳥群、人類文化和蟻群
「少樣本遷移」	指	模型僅憑少量示例就能適應新任務的能力，透過運用先驗知識和高泛化技能，使其能夠在新情況下迅速學習並應用
「柔性製造」	指	一種以適應性優先的生產方法，認可對變化是製造業務（無論規模大小）中不可避免的一部分
「異構機器人」	指	由不同類型、功能和結構的機器人組成的系統，需要統一且協同控制
「IMU」	指	慣性測量單元

## 技術詞彙表

「工業級」	指	專為承受比消費性產品更極端環境條件而設計的化學品或產品；用於商業及工業應用
「intrabay」	指	物料在生產區域(bay)內不同生產設備之間的自動上下料及運輸
「interbay」	指	不同生產區域之間的物料轉移，連接整個工廠的不同生產區域
「激光雷達」	指	光探測與測距，一種通過以激光照射目標並分析反射光來測量距離的遙感裝置及技術
「量產」	指	採用自動化智能製造及工程設施，確保產品一致性、降低人力成本、提升利用率，從而實現成本效益的大規模生產階段
「MCU」	指	微控制器單元
「元任務」	指	能夠對基礎任務進行組合調度的智能規劃能力，以實現複雜的高層指令
「多模態」	指	人工智能同時理解與處理多種信息形式的的能力
「多傳感器信息融合」	指	來自多個傳感器的數據組合
「點雲」	指	掃描過程的輸出結果，當中包含大量點位，共同呈現掃描後的場地狀況
「研發」	指	研究及開發
「RAG」	指	檢索增強生成，人工智能中的一種技術，結合信息檢索和文本生成來提高生成回答的質量、準確性和相關性
「RCC」	指	管理、協調及監督自動化環境中多個機器人操作的集中式計算系統或軟件模塊
「強化學習」	指	機器學習的一個分支，其中代理通過與環境交互來學習決策，以最大化累積回報。與監督學習不同，強化學習並不依賴標記數據，而是透過獎勵信號的引導，以試錯的方式學習
「SEMI」	指	國際半導體產業協會是一個全球性行業組織，致力於推動半導體及顯示器製造供應鏈的發展與利益

---

## 技術詞彙表

---

「SEMI SECS/GEM」	指	實現半導體設備與主機電腦之間自動化控制和數據採集的通信標準
「SLAM」	指	同步定位與地圖構建，一種機器人使用的運算技術，用於建立環境地圖的同時確定自身位置，以實現導航及空間感知功能
「Sub Fab」	指	位於晶圓製造廠潔淨室正下方的關鍵設備支持層
「視覺SLAM」	指	視覺同步定位與地圖構建
「VLA」	指	視覺語言動作模型，能夠直接將視覺信息和語言指令轉換為機器人控制動作的人工智能模型
「VLM」	指	視覺語言模型，一種人工智能模型，集成了計算機視覺及自然語言處理技術，通過跨模態推理解讀視覺內容並處理／生成文本信息。